

---

# 公司简介

---

2014年09月



杭州长川科技公司介绍

# 长川科技

- ◆ **公司定位**：公司成立于2008年，专注于集成电路装备的研发、生产和销售；
- ◆ **产品方向**：1) 测试设备：测试系统、自动分选系统、探针台等；  
2) 封装设备：装片机、倒装机等；
- ◆ **硬件资源**：公司拥有厂房面积近5000平方，约180名员工，其中本科及以上学历人员80人，占45%；年生产能力超过500台；
- ◆ **荣誉资质**：2009年9月认定为软件企业，2010年11月被认定为国家高新技术企业。

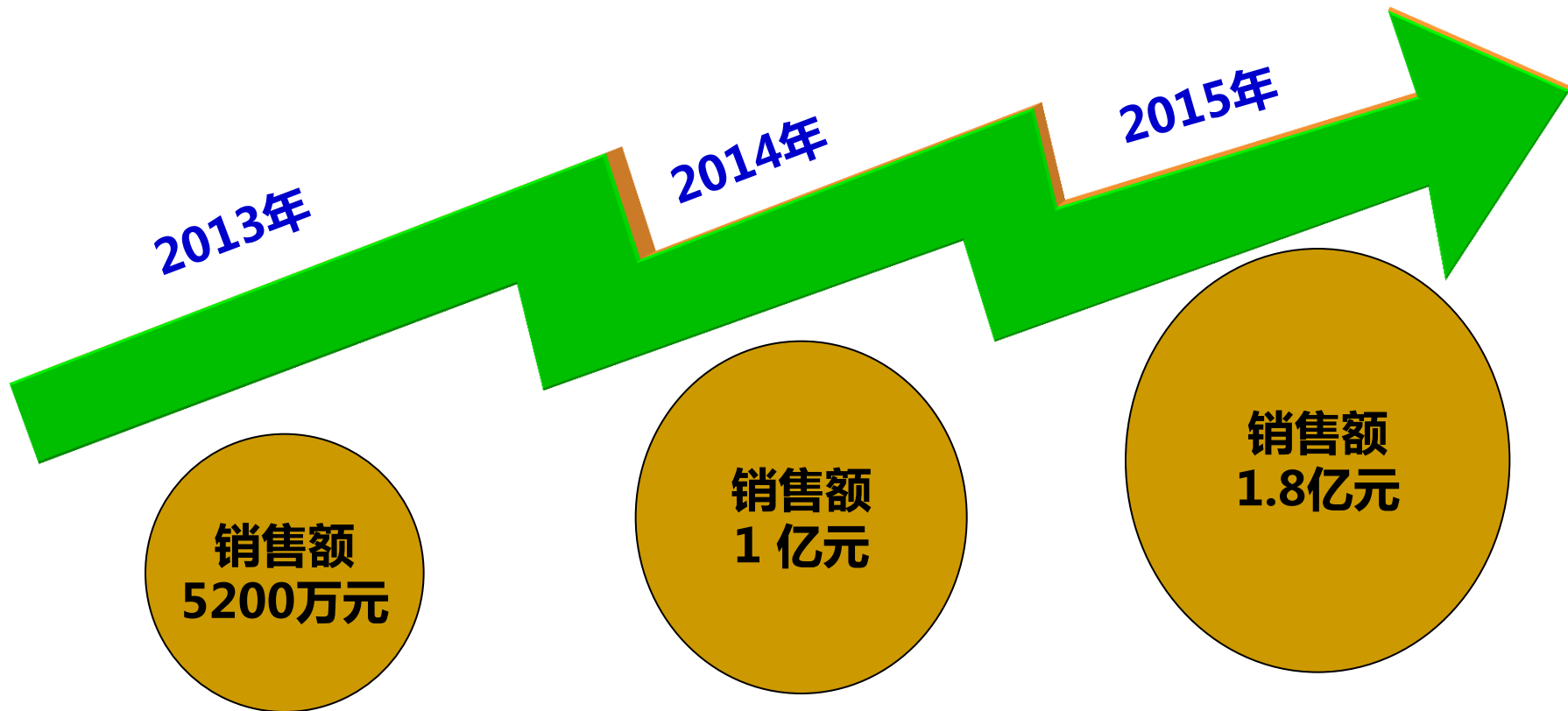


# 发展历程

- ◆ 08年04月 公司注册成立
- ◆ 09年09月 被评定为浙江省软件企业
- ◆ 10年11月 被评定为国家级高新技术企业
- ◆ 11年06月 通过ISO9001质量管理体系认证
- ◆ 11年08月 与投资机构浙江天堂硅谷达成战略合作
- ◆ 13年08月 与浙大机械系合作成立产学研基地
- ◆ 14年07月 与浙大工研院在常州组建IC封测装备技术研究中心
- ◆ 14年09月 申报杭州市研发中心
- ◆ 14年10月 申报浙江省省级企业研究院



# 经营业绩



未来5年是公司的高速成长期，年销售额将达到5亿！



# 研发体系

近70名研发工程师

研发管理部和2个  
研发部

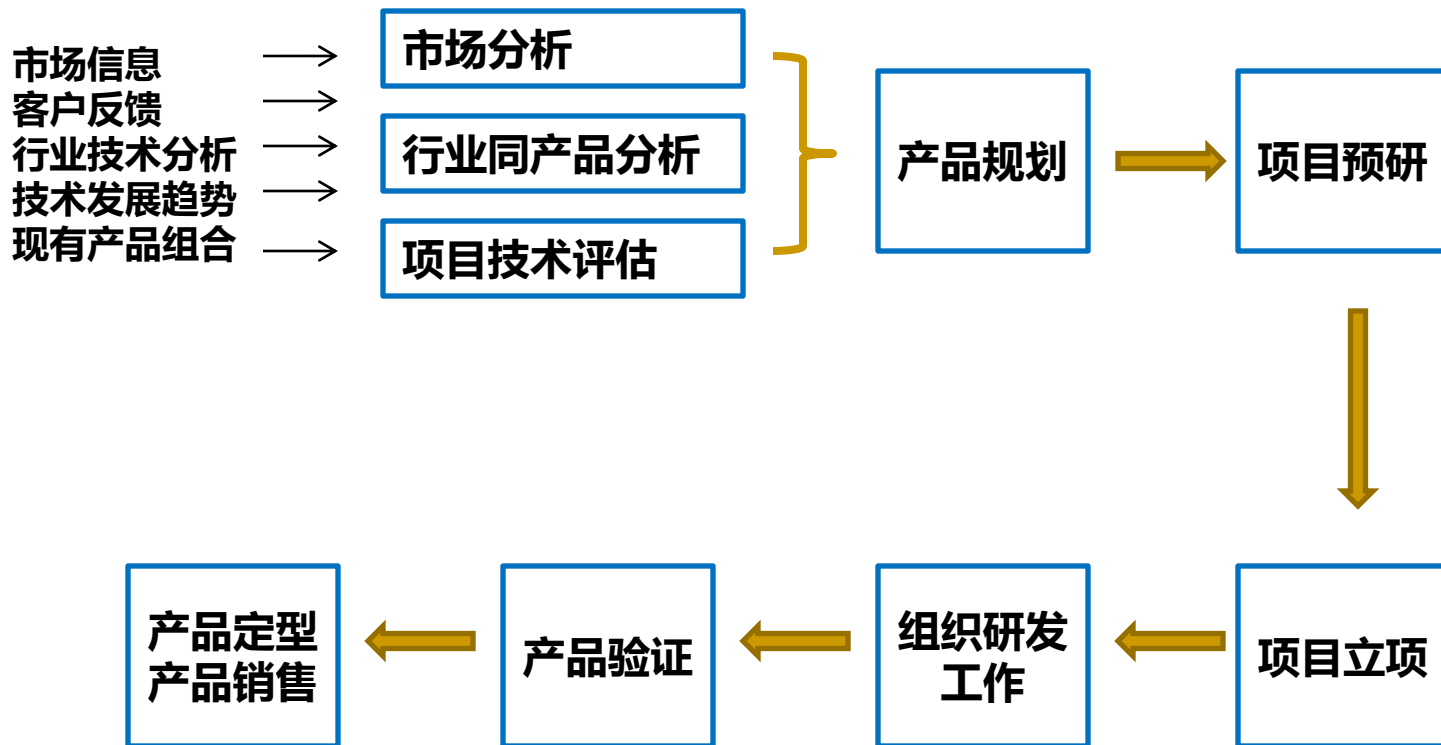
研发  
体系

研发投入：近20%的年销售额

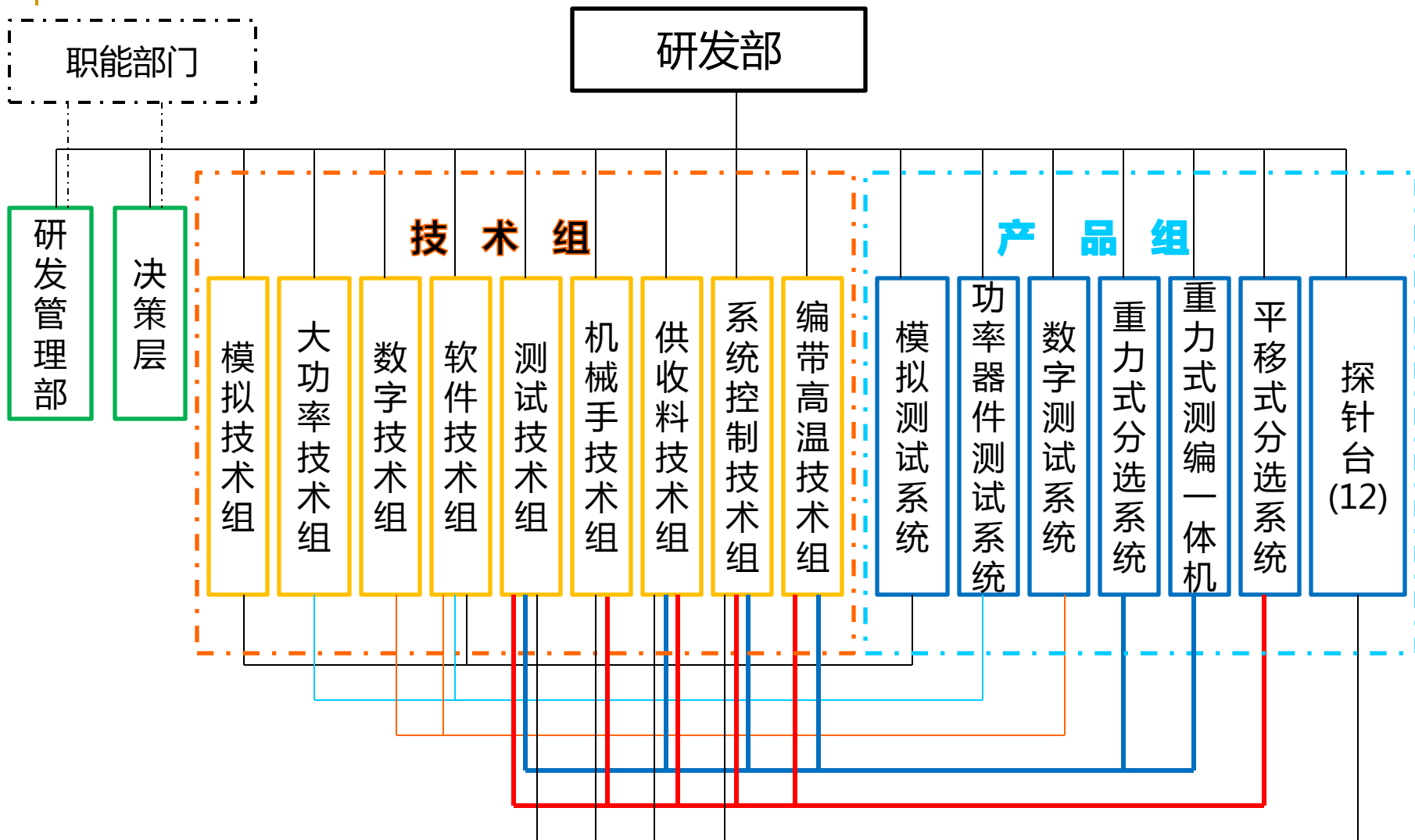
3条测自动试系统产品线  
4条分选机产品线



# 产品研发流程



# 技术组和产品组的矩阵式管理



# 研发成果

- ◆ **专利**：已申请41项，其中发明专利15项；
- ◆ **计算机软件著作权**：已取得19项。





# 产品---测试系统



CTA8200



CTA8280

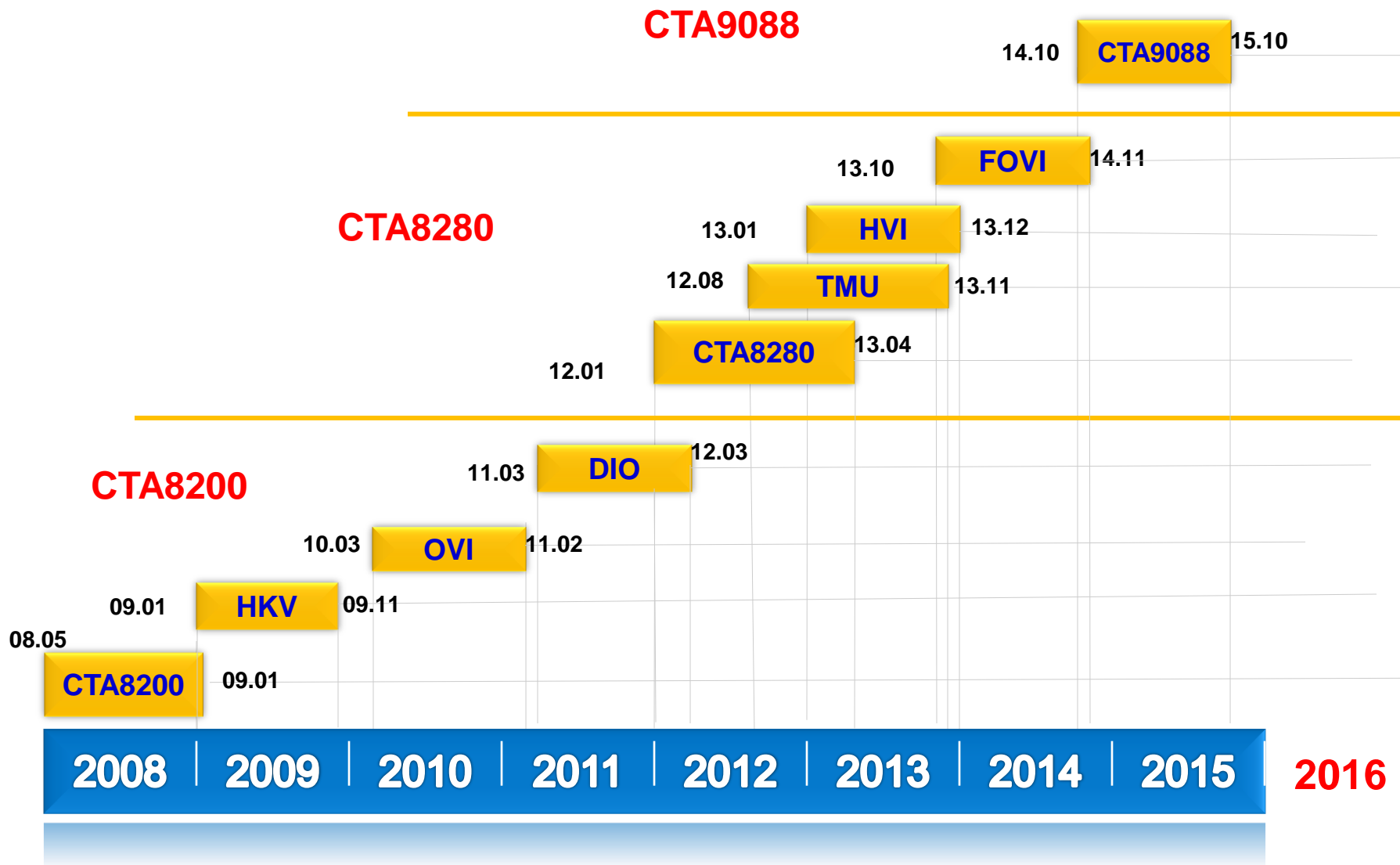


CTT3600



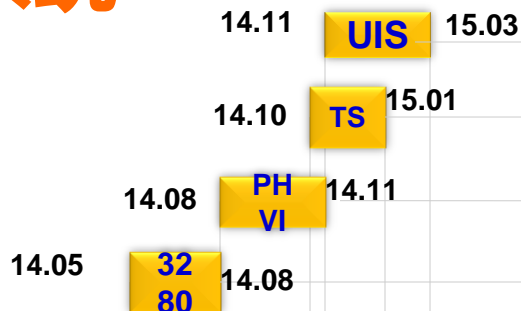
CTT3280

# 模拟测试系统

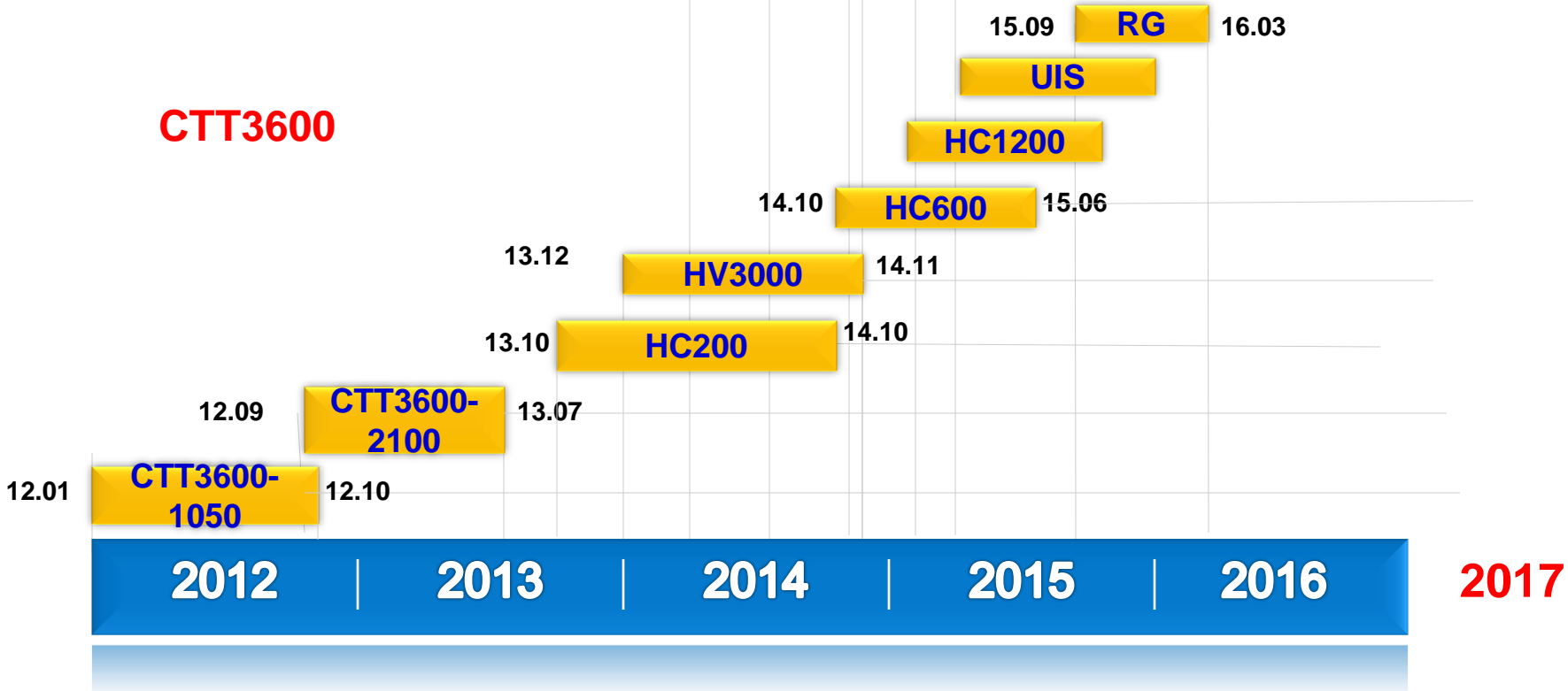


# 功率器件测试系统

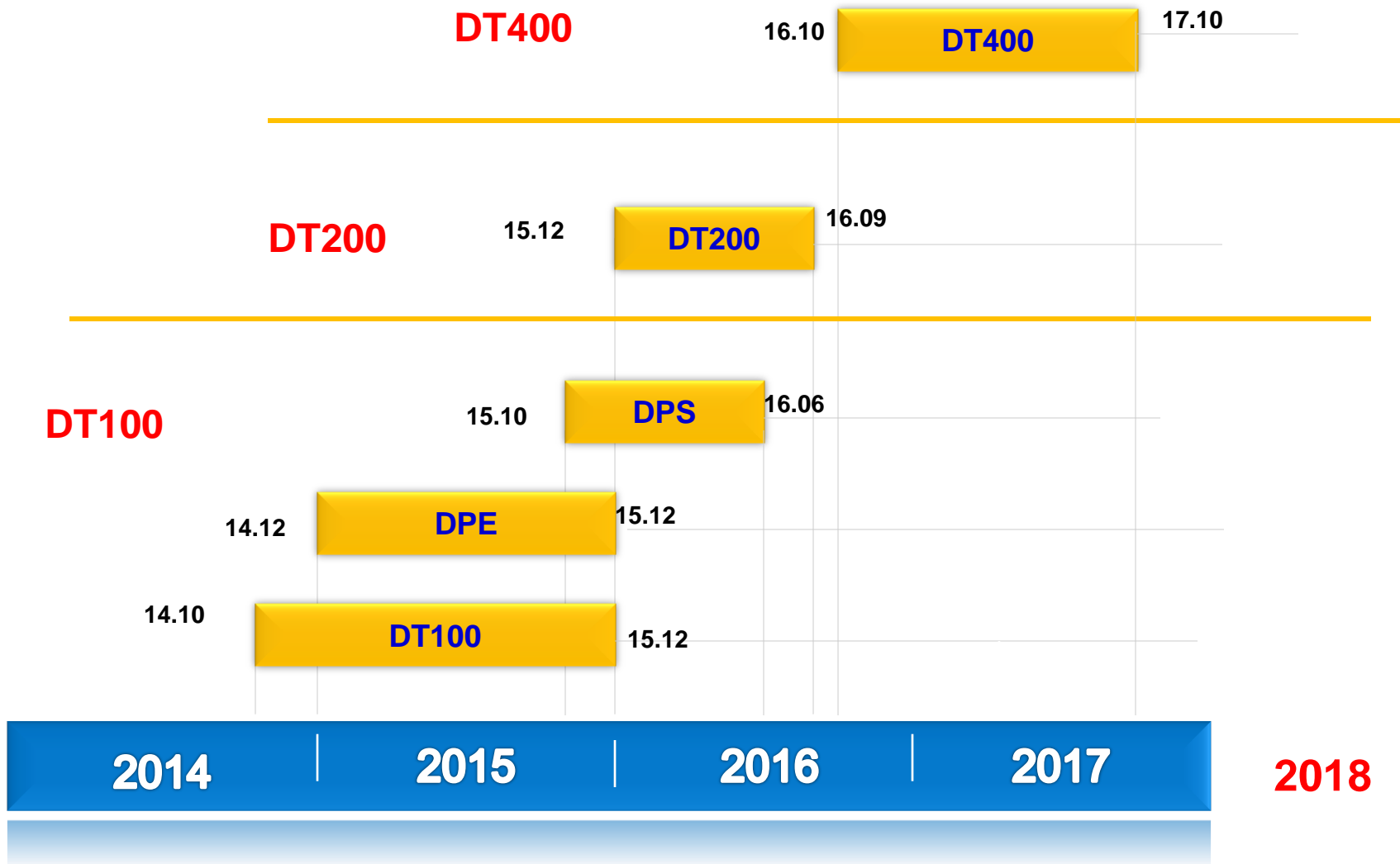
## CTT3280



## CTT3600



# 数字测试系统



# 产品---分选系统



C3



C8

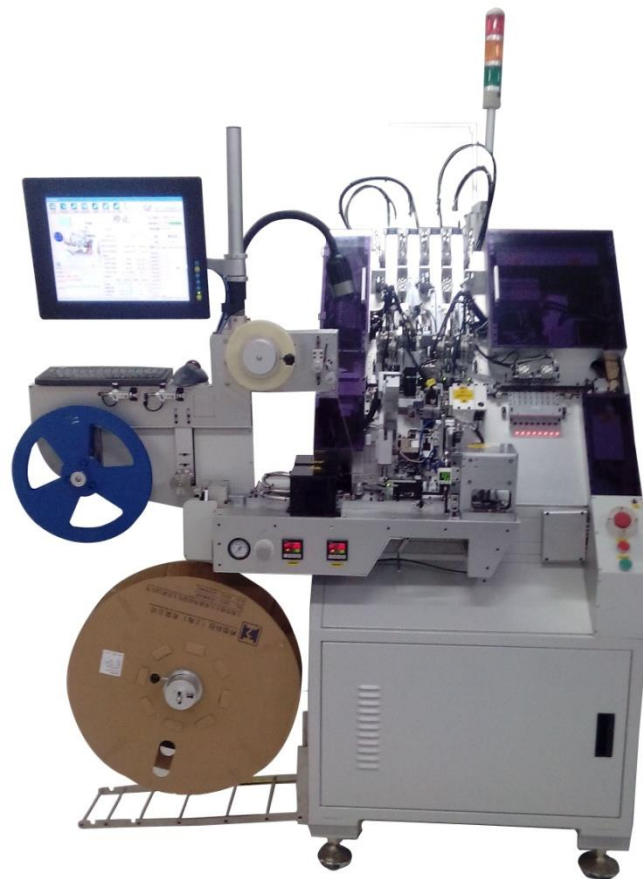


C5

# 产品---分选系统



C7



C9

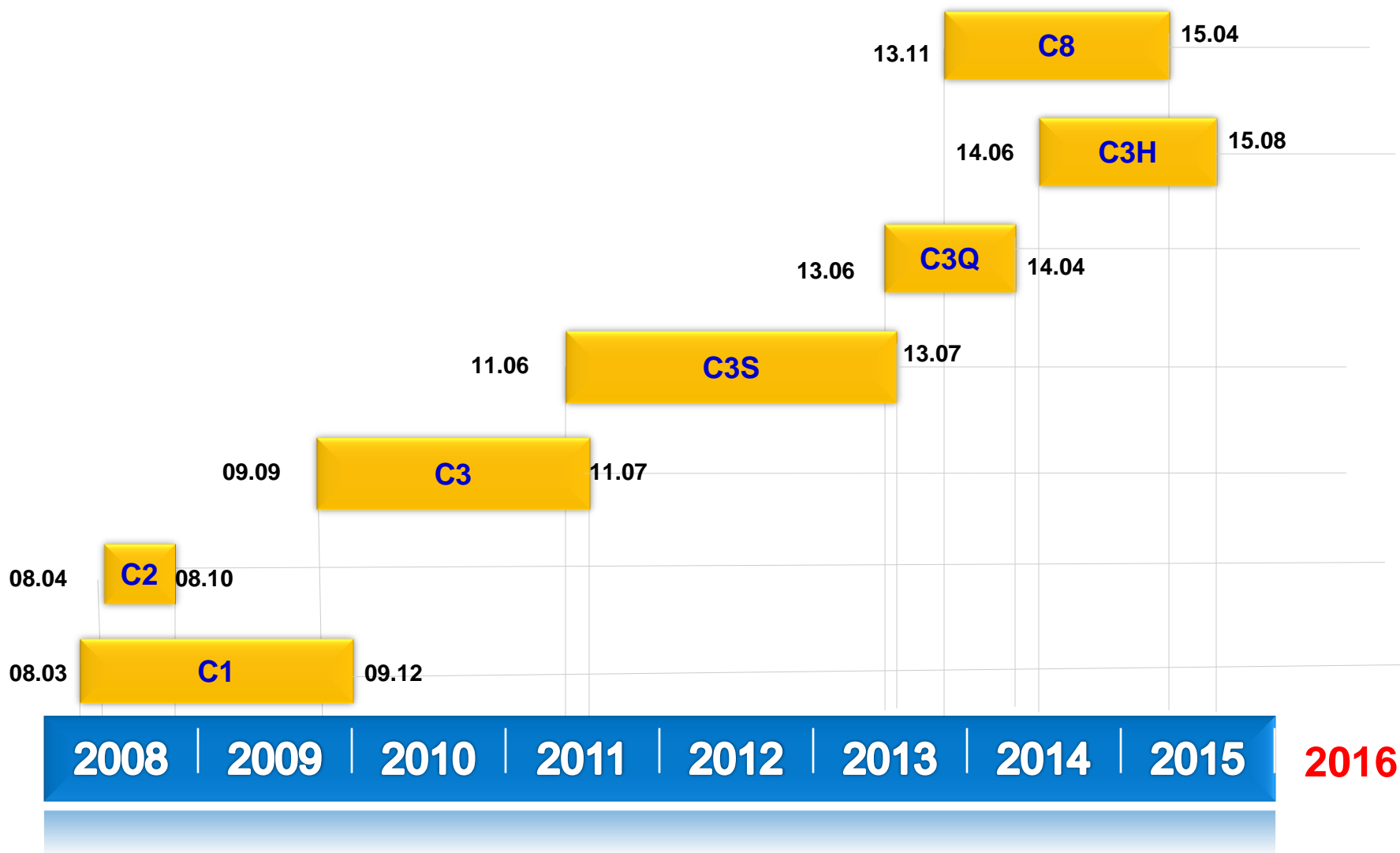


C7Q



C6

# 重力式分选系统 ( Tube To Tube )

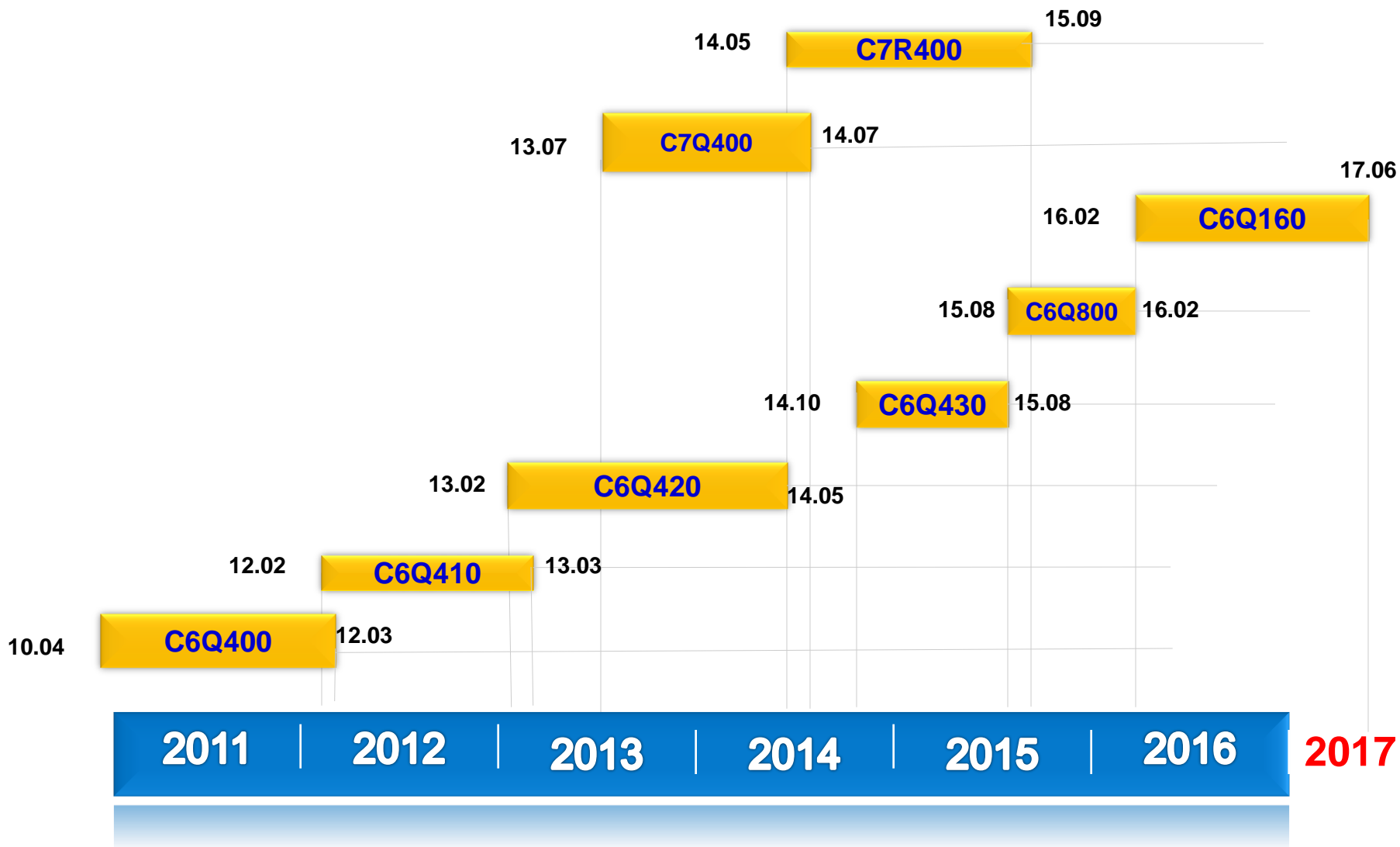




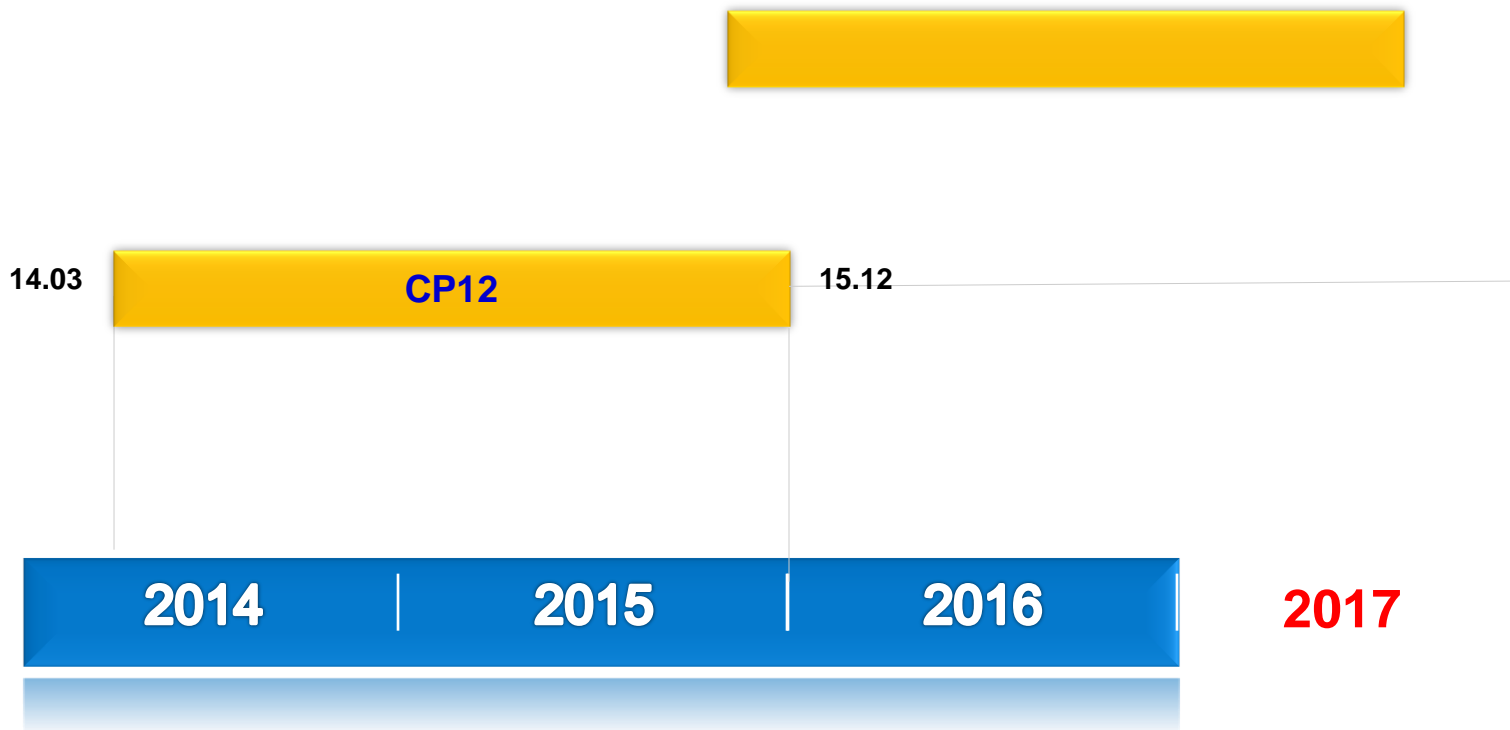
# 重力式测编一体机 ( Tube To Reel )



# 平移式分选系统 ( Pick-Place )



# 探针台 ( 12" Prober )



# 未来封装设备规划

磨片机、划片机、装片机、倒装机等

机电一体化 封装制造设备

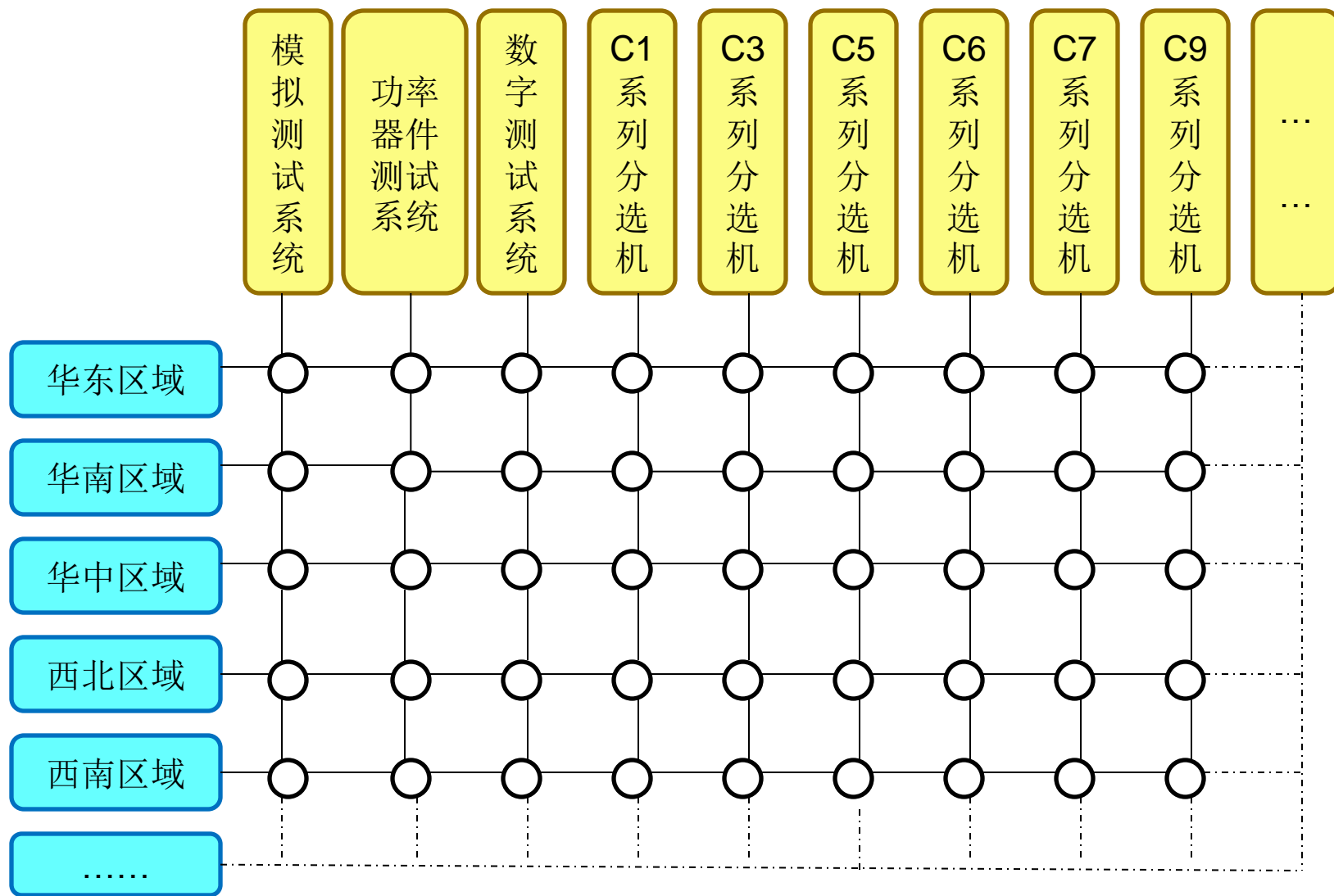


# 销售体系

主要客户



# 区域与产品线的矩阵式销售管理



# 销售体系

## ◆ 市场规划：

按照产品、用户和地区三个维度规划、开拓市场

## ◆ 营销策略：

国内陆资企业—国内合资企业、外资企业---东南亚市场

---欧美市场

## ◆ 推广策略：

销售、研发和客服三位一体的市场推广策略

## ◆ 品牌建设

从研发、市场、生产、质量、服务等全方位建设，将长川科技建  
打造成为国际一流品牌



# 承担项目

- ◆2009年 杭州市种子资金
- ◆2010年 国家创新基金项目
- ◆2011年 杭州市信息服务业发展专项资金
- ◆2011年 杭州市重点产业（工业和信息化专项）发展资金项目
- ◆2012年 承担国家十二五规划02专项课题（2个）
- ◆2012年 浙江省信息服务业发展专项
- ◆2013年 2014年度火炬计划
- ◆2013年 2014年省信息服务业发展专项资金
- ◆2013年 浙江省重大科技国际合作专项
- ◆2014年 浙江省重大科技专项（申报中）



# 承担国家02专项

◆项目名称：通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程

课题名称（一）：SIP吸放式全自动分选机（Pick-Place）

应用范围：适用于QFP、QFN、BGA等高端封装外形IC的测试

状态：已批量生产销售

客户：江苏长电、天水华天、华润安盛、苏州ASE等大型封测厂

# 承担国家02专项

◆项目名称：通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程

课题名称（二）：高压大电流测试系统（CTT3600）

应用范围：适用于高压、大电流的大功率器件、模块的电参数测试

状态：已通过江苏长电、南通富士通的认证

江苏长电、杭州士兰微在线量产

# 公司未来规划

- ◆ **国防安全之必要**：从“棱镜门”“监听门”看出，IC产业发展不仅影响我国的电子产品业，也与国家信息安全息息相关；
- ◆ **产业发展之必要**：IC装备技术是IC生产制造的基础，而中国大陆正成为全球IC制造中心，对IC装备存在巨大的潜在需求；
- ◆ **IC装备国产化之必要**：目前中高端的IC装备完全依靠进口，国家集成电路产业的振兴，装备国产化是基础！

# 公司未来规划

## ◆研发规划

- 1、测试设备的研发以电源管理、通讯产品（RF）、MEMS传感器、LCD驱动、MCU和IGBT等终端测试应用为方向研发生产；
- 2、封装设备将以磨片机、划片机、装片机、倒装机等机电一体化产品为方向进行研发生产。

# 公司未来规划

## ◆ 人才技术规划

- 1、自有人才的培养与研究；
- 2、与高校合作研究；
- 3、同行优秀人才的引进：

# 公司未来规划

## ◆ 资金规划

- 1、自有资金的筹备；
- 2、引进风投资金；
- 3、未来2-3年左右IPO；
- 4、政府相关资金的支持



# 公司未来规划

## ◆国际合作

长川科技要成为国际一流集成电路装备供应商，通过国际合作引进技术专家、突破关键技术、开拓海外市场尤为重要！

- ◆**引进技术的需要**：从国外引进前沿技术，突破集成电路装备国产化技术瓶颈，提升国产化设备竞争力；
- ◆**引进人才的需要**：从国外引进相关领域专家，提升集成电路装备研发能力；
- ◆**开拓市场的需要**：可以通过国外合作方降低进入市场的门槛，或者沿用其现有的国际市场，帮助公司拓展海外市场。

# 与日本合作计划

**日本是全球半导体装备业最发达的国家，在全球处于领先地位：**

**如：Advantest（爱德万）、ACCRETECH(东京精密)、TEL（东京电子）、Epson（爱普生）、Ueno Seiki（上野精机）等。**

**由于日本在消费电子行业错失良机，导致日本半导体行业衰退非常明显，日本半导体装备业发展呈停滞状态，为我们提供市场机遇。**



# 公司的目标

- ◆ **目标一:培养一支具有国际顶尖水平的研发队伍**
- ◆ **目标二:突破关键技术,打破欧 美日的技术 \ 市场垄断**
- ◆ **目标三:把长川科技打造成为国际一流的集成电路装备供应商**
- ◆ **目标四:为振兴国家集成电路装备产业做贡献**

---

谢谢!